

证券代码：600641 证券简称：先导基电

上海先导基电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	华夏基金管理有限公司 上海贤盛投资管理有限公司 第一创业证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 申万菱信基金管理有限公司 华西证券股份有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 国海证券股份有限公司 大和证券（中国）有限责任公司 国联民生证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 建信基金管理有限责任公司 博时基金管理有限公司 惠理投资管理(上海)有限公司 Balyasny Asset Management L.P.

	<p>东吴证券股份有限公司</p> <p>浦银安盛基金管理有限公司</p> <p>招商证券股份有限公司</p> <p>上银基金管理有限公司</p> <p>平安基金管理有限公司</p> <p>德邦基金管理有限公司</p> <p>开源证券股份有限公司</p> <p>国联基金管理有限公司</p> <p>易方达基金管理有限公司</p>
时间	2026 年 1-3 月
地点	公司现场、线上会议
上市公司 接待人员姓名	<p>先导基电董事长兼总裁 朱世会先生</p> <p>先导基电副董事长兼副总裁 余舒婷女士</p> <p>先导基电副总裁兼董秘 周伟芳女士</p> <p>先导基电首席财务官 叶蒙蒙女士</p> <p>先导基电投资者关系经理 俞佳卉女士</p> <p>先导基电投资者关系经理 傅欣璐女士</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>主要交流问答：</p> <p>Q：请问公司 2025 年营收增长由哪些因素驱动？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司 2025 年营业收入实现跨越式增长，根据公司 2025 年年度业绩预告，报告期内预计实现营业收入 17-20 亿元，预计较上年同期增长 192.38%到 243.98%。营收增长源于公司的两块主要业务：铋材料业务和半导体专用设备制造业务，2025 年公司紧抓市场机遇，借助大股东先导集团新业务的置入，不断强化自身核心制造、研发和商务能力建设，增强订单获取与交付能力，积极提升现有业务的市场份额。感谢您的提问！</p>

Q: 公司 2025 年业绩预告显示营收大幅增长但净利润出现亏损, 主要原因是什么?

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司 2025 年预计实现营业收入 17-20 亿元, 同比增长 192.38%到 243.98%, 实现跨越式增长。净利润为负主要源于公司的战略性投入: 一是为增强在半导体设备及零部件领域的技术领先优势, 公司进一步扩充专业技术及管理团队, 导致研发及管理费用进一步增加; 二是为持续加大业务拓展力度, 抢占市场份额, 公司进一步打开融资渠道, 财务费用较上年同期相应增加; 三是公司主动优化资产结构, 转让部分参股公司股权, 根据会计准则, 需在处置当期按照处置收益一次性确认所得税费用, 致使当期所得税费用增加。上述投入将有效完善公司半导体业务产业链布局、提升长期竞争力, 短期内虽导致业绩承压, 但为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。感谢您的提问!

Q: 公司半导体设备及零部件业务目前研发投入占比如何? 预计何时结束高投入期并开始贡献正向利润?

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司当前正处于半导体设备及零部件业务的关键战略投入期。为增强在上述领域的技术领先优势, 公司进一步扩充了专业技术及管理团队, 相关研发及管理费用有所增加, 占比较高。上述战略性投入旨在有效完善公司半导体业务的产业链布局, 为公司的长期可持续发展奠定坚实基础。

半导体行业具有资本与技术密集型特性, 前期高投入是成长型公司构建技术壁垒、完善产业布局的普遍特征。公司将持续优化投入产出效率, 推动业务实现规模效应, 具体经营成果及盈利情况将在后续定期报告中及时披露, 请各位投资者持续关注。感谢您的提问!

Q: 近期铍价持续上涨, 请问对公司的存货价值和未来业绩有何影响?

A: 尊敬的投资者, 您好! 关于存货增值的问题, 根据会计准则, 公司存货采用历史成本计价, 即按购入时的实际成本入账, 而非期末市场价格计量, 因此存货的市场价格上涨本身不会直接体现于 2025 年当期损益中。该部分增值空间将随着后续生产流转, 逐步体现在公司未来下游的市场销售及与客户的深度合作当中。目前, 公司凭借充裕的原料储备及稳定的交付能力, 已与多家核心客户建立长期战略合作关系, 获取长期订单的能力显著增强, 为公司未来持续盈利能力提供坚实保障。感谢您的提问!

Q: 公司如何应对铍金属价格波动风险?

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司一是积极的采购与库存策略。公司基于生产经营与新增产能需要, 提前进行了一定规模的原材料备货。此举既为生产提供保障, 也通过分批次采购平滑价格波动风险, 增强议价能力。同时公司基于对国内外消费市场和政治地缘经济变动的预判, 动态调整采购策略, 以应对原材料价格波动和下游消费市场的变动。

二是利用海内外价差优势。目前国内铍价处于 15 万元/吨 - 17 万元/吨的区间, 而海外价格达 25 万元/吨 - 30 万元/吨, 该价差为我们带来显著的报价竞争力, 获取更多的海外客户的订单, 与客户建立长期战略合作。

三是聚焦高潜力下游市场与客户。公司重点拓展布局电子半导体、新能源、医药等新兴战略客户, 提供定制化解决方案, 增强客户黏性。同时, 在一些成熟的应用领域持续拓展份额, 扩大销售规模。

展望未来, 公司通过灵活动态的库存策略、积极稳定扩产带来的规模效应、高潜力下游客户的挖掘覆盖, 以及上游供应链的稳定性建设, 将多维度协同提升铍业务的整体盈利水平。感谢您的提问!

Q: 能否介绍一下凯世通离子注入机业务最新进展?

A: 尊敬的投资者, 您好! 2026 年一季度, 公司旗下凯世通已成

功向国内头部芯片制造客户完成低能大束流离子注入机新产品复购订单交付。此外，2026年3月SEMICON China 2026期间，凯世通发布Hyperion先进制程大束流离子注入机与iKing 360中束流离子注入机两大系列新品，覆盖先进逻辑、先进存储、碳化硅（SiC）、化合物半导体、IGBT及SOI材料等多元应用场景，以产业驱动、自主创新，攻克核心技术卡点、打破国外垄断，为国内先进工艺芯片制造与宽禁带半导体等产业化发展，提供关键设备支撑。

在先导科技集团的协同赋能下，凯世通正加快新产品技术开发与成熟产品持续升级，构建多场景全谱系产品矩阵，不断满足不同客户的差异化需求。同时，凯世通聚焦突破核心零部件“卡脖子”难题，夯实供应链安全基座，以自主可控的全周期一站式服务方案赋能客户工艺创新。新的一年，公司将继续深化与国内集成电路客户的协同创新，加快更多新产品的技术验证与市场导入，积极为国家集成电路产业发展贡献力量。感谢您的提问！

Q：公司离子注入机在先进工艺节点的技术突破计划是什么？

A：尊敬的投资者，您好！目前，全球离子注入机的发展有两个方向。一方面，是朝着更先进工艺方向发展，对离子注入机的要求是更精准地控制和更好的颗粒污染控制。其中，颗粒污染控制在未来先进工艺中要求极高。针对这一领域，凯世通开发了面向先进工艺的低能大束流离子注入机，目前已经送至客户端开始进行验证，产品在颗粒污染控制、元素污染控制等方面提升显著。另外一方面，离子注入机朝着多元化应用领域的方向发展，核心驱动力来自半导体器件制程的不断微缩和新兴材料衍生出新的需求。凯世通将围绕离子注入技术广泛布局，做精做深，实现全系列离子注入机的布局和产业化。感谢您的提问！

Q：随着中国大陆成为全球最大设备市场及国产化政策导向的加强，晶圆厂扩产已成定局。请问公司如何看待这一轮扩产周期？如何

抓住发展的机遇？

A：尊敬的投资者，您好！当前全球半导体设备市场景气度持续，行业研究数据显示，中国大陆市场已连续第十个季度位居全球最大半导体设备市场。在自主可控政策导向下，半导体设备国产化进程预计将进一步提速。

公司已构建涵盖半导体核心装备、新型材料及精密零部件的平台化硬科技产业布局。公司明确“Around Fab”目标定位，即围绕晶圆厂客户平台，向其提供晶圆制造所需的日常耗材、先进工艺设备及支撑上述设备和耗材的核心零部件，已形成从材料到装备再到零部件的完整产品矩阵。

凯世通持续瞄准先进工艺技术迭代，并已推出低能大束流新机型，性能对标国际领先机型。同时，公司大力发展面向碳化硅、氮化镓等材料的束流及高能机等全系列产品体系。

面对本轮扩产周期，公司将紧抓国产替代战略机遇，充分发挥在设备、材料、零部件领域的多重优势，推进先导基电整体业务的稳健发展，持续提升核心竞争力。未来，公司也将充分依托先导科技集团的产业资源赋能，推进产业链的协同发展。感谢您的提问！

Q：公司 TEC 制冷片业务近期有何进展？能否简要介绍产品定位及市场前景？

A：尊敬的投资者，您好！公司 TEC（热电制冷器）业务由新设主体衢州万导热电科技有限公司统筹推进，目前已完成团队搭建、产线规划及关键设备部署，正按计划推进 Micro-TEC 产品的工程验证与客户送样工作。

Micro-TEC 是一种面向高精度温控场景的微型半导体制冷器件，具有体积小、响应快、控温精准、无运动部件等优势，广泛应用于高速光通信模块、激光雷达、高端医疗检测设备及精密电子系统等领域。该细分市场长期由海外厂商主导，国产化率低，但随着国内在数据中心、智能驾驶、先进制造等领域的快速发展，对高性能 Micro-TEC 的

自主供应需求日益迫切，市场空间广阔。

公司依托在碲化铋基热电材料领域的全链条能力，从原材料到终端器件一体化布局，具备快速响应和定制化开发优势，预计 2026 年将逐步实现小批量交付，并为后续规模化放量奠定基础。感谢您的提问！